

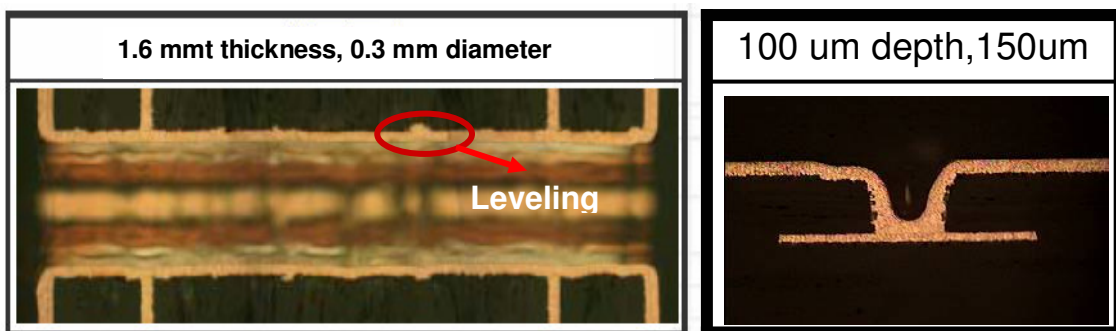
羅門哈斯公司將於 TPCA 展推出最新的先進電鍍銅製程

Copper Gleam™ HV-101 & Copper Gleam™ MV-100
 垂直連續式電鍍線上之高性能、最佳化電鍍銅製程

2008 年 9 月 26 日臺灣大園報導 – 羅門哈斯電子材料公司 (Rohm and Haas Electronic Materials, 紐約證券交易所: ROH) 旗下的印刷線路板技術事業部 (CBT, Circuit Board Technologies) 將於本年 10 月 22 至 24 日 TPCA 2008 展 L716 攤位展出, 推出一系列先進的製程及產品, 其中 Copper Gleam™ HV-101 與 Copper Gleam™ MV-100 是最新一代電鍍銅製程。對於目前市場主流的垂直連續式電鍍線, 開發出特用的光澤劑, 相較於傳統電鍍光澤劑, 具備優越的電鍍特性與量產的優勢, 客戶可根據其不同的需求, 選擇不同之光澤劑系統。

Copper Gleam™ HV-101 與 Copper Gleam™ MV-100 的特性及優點包括高電鍍效能提升其通孔與微盲孔之貫孔力, 可有效減少鍍層厚度, 以達到提高產能與降低電鍍製程成本之目的; 表面與孔內有均具有良好的整平效果, 有助於克服高粗糙度之通孔鍍銅品質, 降低各種孔壁狀況不良所造成之缺陷發生率; 於盲孔底部之圓孔效果, 可減少盲孔折鍍之現象, 並可增加組裝良率。

「針對不同客戶別產品的需求, 我們於今年度提供兩種全新的光澤劑系統, 以滿足 HDI 板與載板電路板產業的需求, 以最先進的科技協助客戶克服生產所面對的問題。」CBT 全球技術總監簡浩洋說。可完全分析之光澤劑更可有效的控制電鍍槽液狀態並提供穩定的電鍍品質。



切片圖: (1)通孔之整平效果表現(2)盲孔底部之圓孔效果。

Copper Gleam, 羅門哈斯與羅門哈斯電子材料皆為羅門哈斯公司或其關聯公司的商標

關於羅門哈斯公司

羅門哈斯（紐約證券交易所：ROH）是為特殊材料行業創造研發創新技術和解決方案的一家全球先鋒企業，自 1909 年以來一直引領業界潮流。該公司的技術在業界得到了廣泛的應用，其中包括：建築與建設、電子與電子設備、家用品與個人防護、包裝與紙張、運輸、藥物與醫療、飲用水、食品及食品相關、以及工業過程。Rohm and Haas 的創新技術和解決方案每天都在全球幫助改善人們的生活。該公司位於美國賓夕法尼亞州費城，2007 年創營收額約 89 億美元。請參閱網頁 www.rohmhaas.com 瞭解更多資訊。

關於羅門哈斯電子材料事業群

羅門哈斯電子材料事業群（Rohm and Haas Electronic Materials）為電子和光電子行業開發、提供創新型材料解決方案和製程。其產品和技術側重於電路板、半導體生產、高級封裝和顯示器行業，是全球各地電子產業不可缺少的組成部分。更多資訊，請瀏覽網站 www.rohmhaas.com。

印刷線路板技術事業部的產品包括印刷線路板及太陽能電池製造中金屬化及影像轉移製程所需的化學材料，在臺灣大園、中國東莞、香港、日本新瀉及美國麻塞諸塞州均設有工廠。

媒體聯絡人：

羅門哈斯電子材料公司

謝嘉雯 Elysia Hsieh

電話：+886-3-574-5472

電子郵件：elysiahsieh@rohmhaas.com